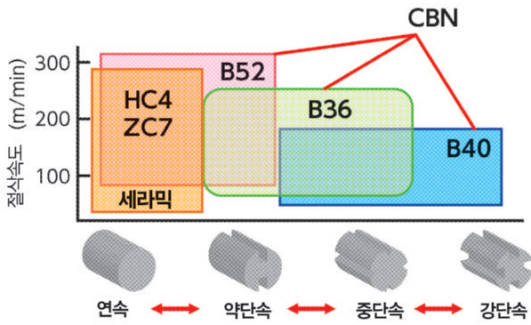


# 고경도재 가공

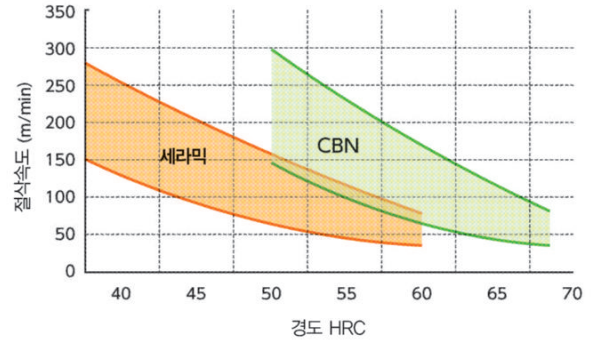
## 고경도재 가공에 있어서의 NTK 공구 선정 기준

### 공구 재질 선정



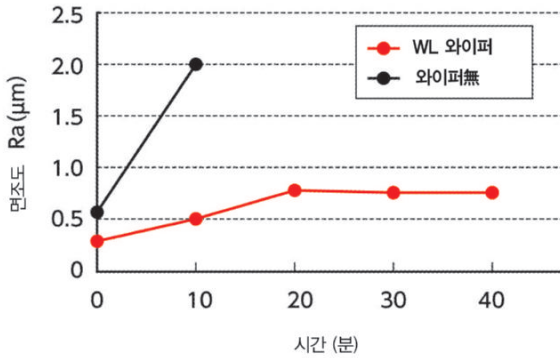
### 추천 절삭속도

(경도별 추천 절삭속도 (연속가공))



### 와이퍼 효과

CNGA120412WL  $v_c=100\text{m/min}$   $f=0.1\text{mm/rev}$   $a_p=0.5\text{mm}$

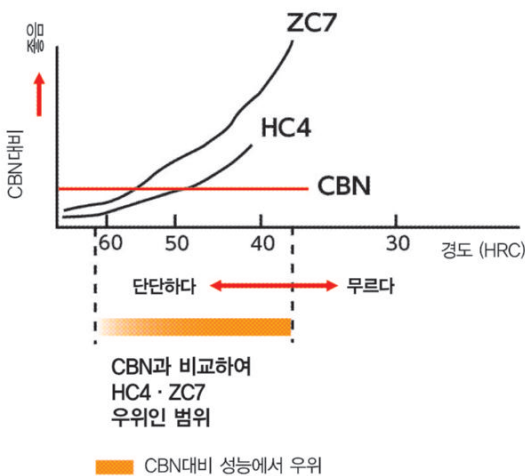


### 추천 절입량과 이송량

【코너R 사이즈별 추천 절입량과 이송】

코너R	절입량 (mm)	이송 (mm / rev)
R0.4	0.15	0.05 ~ 0.08
R0.8	0.3	0.08 ~ 0.10
R1.2	0.4	0.10 ~ 0.13
R1.6	0.5	0.13 ~ 0.16
R6.35	2.0	0.16 ~ 0.25

### 세라믹의 우수성



### 칩 처리

세라믹 공구 "ZC7"에 "AG 브레이커"를 채용하여 칩 처리문제에 의한 가공면 불량이나 기계정지가 개선되어 장시간 가동이 가능하게 됩니다.

브레이커 無

AG 브레이커



피삭재 : SCM415 침탄열처리 HRC50  
 사용팁 : ZC7 CNGA(G) 120408  
 $v_c=150\text{m/min}$   $f=0.2\text{mm/rev}$   $a_p=0.2\text{mm}$